

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】令和6年11月21日(2024.11.21)

【公開番号】特開2023-125724(P2023-125724A)
【公開日】令和5年9月7日(2023.9.7)
【年通号数】公開公報(特許)2023-169
【出願番号】特願2022-29986(P2022-29986)
【国際特許分類】

H 0 5 K 3/34(2006.01)

H 0 1 L 23/12(2006.01)

【F I】

H 0 5 K 3/34 5 0 1 D

H 0 1 L 23/12 K

10

【手続補正書】

【提出日】令和6年11月13日(2024.11.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

外部接続用のパッドと、絶縁層と、を有し、
前記パッドの下面の一部は、前記絶縁層に被覆され、
前記絶縁層には、平面視で前記パッドの周囲に位置し、前記絶縁層の上面側に開口する溝が設けられ、

前記溝の底面は、前記パッドの下面と面一である、配線基板。

【請求項2】

30

前記パッドは、前記溝の底面と接するシード層と、前記シード層上に積層された電解めっき層と、を含む、請求項1に記載の配線基板。

【請求項3】

前記電解めっき層は、積層構造であり、

前記電解めっき層は、前記シード層上に積層された銅層と、前記銅層上に積層された表面被覆層と、を含む、請求項2に記載の配線基板。

【請求項4】

前記表面被覆層の外周部は、前記銅層の側面よりも前記溝の内側面側に突出している、請求項3に記載の配線基板。

【請求項5】

40

前記表面被覆層の最上層は金属である、請求項3又は4に記載の配線基板。

【請求項6】

前記表面被覆層の最上層は錫層である、請求項3又は4に記載の配線基板。

【請求項7】

前記錫層の上面は、凸状に湾曲している、請求項6に記載の配線基板。

【請求項8】

前記パッドの前記絶縁層から露出する面に有機被膜が形成されている、請求項1又は2に記載の配線基板。

【請求項9】

前記パッドの上面は、前記絶縁層の上面よりも低い位置にある、請求項1乃至8の何れ

50

か一項に記載の配線基板。

【請求項10】

支持体の上面の所定位置に、犠牲層を形成する工程と、

前記支持体の上面に、前記犠牲層を被覆する絶縁層を形成する工程と、

前記絶縁層上に配線層を形成する工程と、

前記支持体及び前記犠牲層を除去し、前記絶縁層の前記犠牲層を除去した領域に凹部を形成する工程と、

前記凹部内に、前記配線層と接続するように、外部接続用のパッドを形成する工程と、を有し、

前記パッドの上面の一部は、前記絶縁層に被覆され、

10

前記絶縁層には、平面視で前記パッドの周囲に位置し、前記絶縁層の下面側に開口する溝が設けられ、

前記溝の底面は、前記パッドの上面と面一となる、配線基板の製造方法。

20

30

40

50